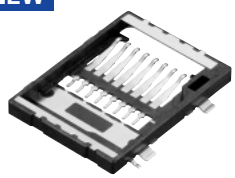
microSD™卡用连接器（插入式）

SCHD系列

RoHS compliant

实现了厚度为1.6mm的薄型类型，提高了组合部件的设计自由度。

NEW



主要规格

项目		规格
构造	合适的媒体	microSD™ 卡
	贴装方式	表面贴装型
	贴装状态	标准贴装
	媒体排出方式	手插拔式
性能	使用温度范围	−20℃ to +70℃
	耐高压	500V AC 1minute
	绝缘电阻（初期）	1,000MΩ min.
	接触电阻（初期）	100mΩ max.
	插拔次数	10,000cycles

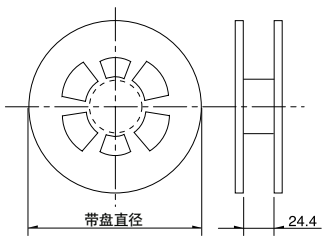
产品一览

媒体排出方式	贴装状态	基准距（mm）	包装状态	产品编号	图号
手插拔式	标准贴装	0	载带	SCHD1A0101	1
				SCHD3A0100	2

包装规格

载带 Unit:mm

卷盘尺寸

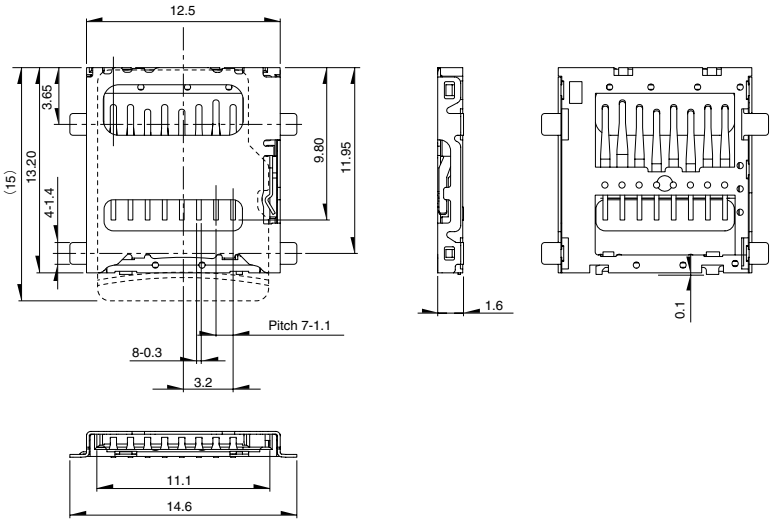
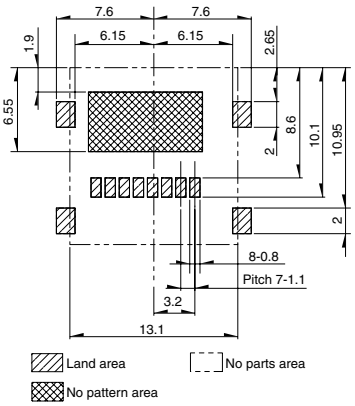
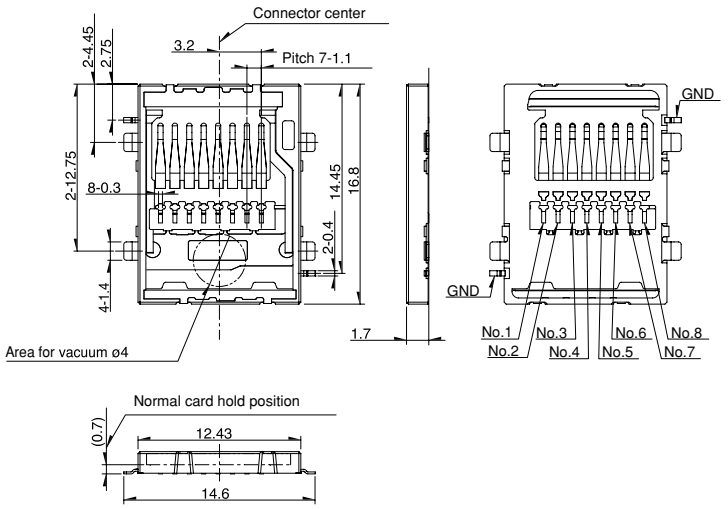
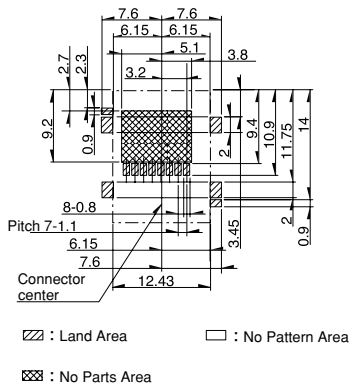


产品编号	包装数（pcs.）			带盘直径（mm）	载带宽度（mm）	出口包装箱尺寸（mm）
	1卷	1箱/日本	1箱/出口包装			
SCHD1A0101	1,400	4,200	8,400	330	24	353×353×249
SCHD3A0100	2,000	6,000	12,000	380		403×403×249

SD内存卡用
microSD™卡用
SIM卡8销用
W-SIM用
Memory Stick Micro™用
Memory Stick™用
组合式
Compact Flash™用
CMOS摄影模块用

外形图

Unit:mm

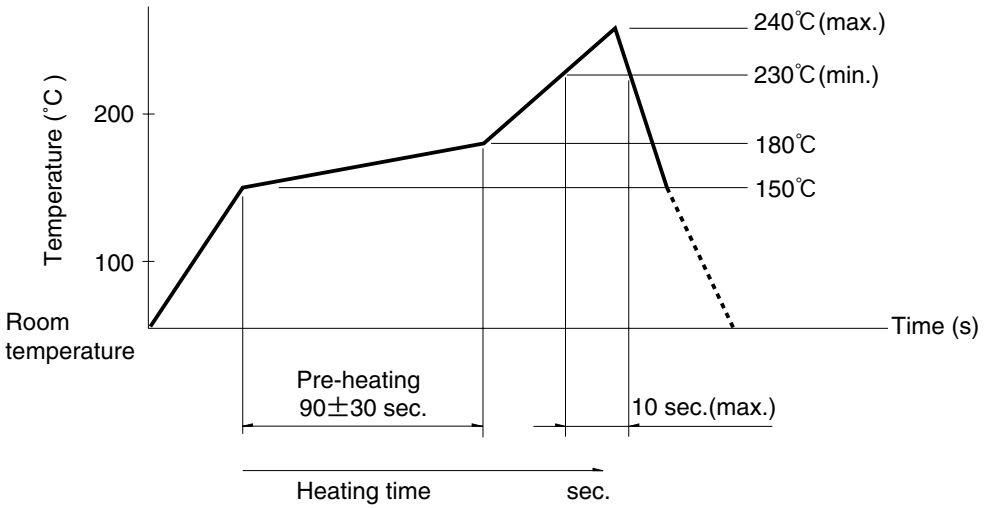
No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图(从贴装面看)
1		
2		

SD内存卡用
microSD™卡用
SIM卡8销用
W-SIM用
Memory Stick Micro™用
Memory Stick™用
组合式
Compact Flash™用
CMOS摄影模块用

焊锡条件

回流方式的参考举例

1．加热方式　　为由热风循环的上下加热方式。
2．温度测量方式　使用φ0.1～φ0.2的CA(K)或CC(T)测量。固定方式采用耐热胶带。
3．温度分布(产品表面)。



使用本产品时的注意事项

1．在对端子进行焊接时，请注意，如果给端子施加负荷，根据条件不同有造成松动，变形及电特性降低的可能。
2．焊接时，水溶性助焊剂有使开关腐蚀的可能，请避免使用。
3．关于回流条件的设定，请根据实际的批量生产条件进行确认。
4．由于电路板的弯曲可能引起特性的变化，请充分考虑模式设计及布局设计。
5．产品对应符合SD Association(SDA)规格，MultiMediaCard(MMCA)规格，CompactFlash Association(CFA)规格，Memory Stick™规格书的卡。使用不符合上述规格的卡时，可能不正常动作。